

2022年(公社)砥粒加工学会賛助会員会 第1回技術交流会のご案内

『パワー半導体と砥粒加工 その1』

— パワーデバイス(化合物半導体)の加工理論と最新加工技術 —

主催:(公社)砥粒加工学会 賛助会員会

【主旨】 砥粒加工学会賛助会員会では、砥粒加工をはじめとしたものづくり技術に関する現状の課題や今後求められる技術について、研究者、工具メーカ、機械メーカ、ユーザなどの異なった立場から語り合う場として技術交流会を開催しています。今回は、「パワーデバイス(化合物半導体)の加工理論と最新加工技術」をキーテーマとして、関連する3件の話題提供をいただくとともに、話題提供者を囲んでディープディスカッションを行います。化合物半導体は新たなパワーデバイス用材料として高い注目を集めています。パワーデバイスのこれまでの開発と今後の期待、加工理論、最先端の取り組みについて産・官・学の方からご講演いただきます。活発で有意義な技術交流会とするために、賛助会員の皆様はもちろんのこと、このテーマに関心をお持ちの幅広い分野の技術者・研究者の皆様にご参加いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

【日時】 2022年7月22日(金) 13:30~17:00 (13:00 開場予定)

【会場】 Cisco Webex Meeting を用いてオンラインを開催いたします。

【内容】 13:30~13:35 開会挨拶

13:35~14:25 パワー半導体用 SiC ウェハ技術のこれまでの開発とこれからの期待

講演者:産業技術総合研究所 加藤智久 氏

14:30~15:20 脆性材料の研磨加工現象のメカニズム

講演者:千葉工業大学 教授 松井伸介 氏

15:20~15:30 (休憩)

15:30~16:20 化合物半導体(SiC)ウェハの高効率、高品位切断加工プロセスおよび専用工具の開発

講演者:三星ダイヤモンド工業株式会社 北市充 氏

16:25~16:55 ディープディスカッション

16:55~17:00 閉会挨拶

*ディープディスカッションの質問は直前までに主催者側で質問をとりまとめる予定です。

講師の方々に質問がある方は、主催者側へチャット入力をお願いいたします。

【参加費】 無料

【定員】 200名(先着順ですが、回線に限りがありますので、賛助会会員の方を優先して受け付けます)

【申込締切】 2022年7月8日(金)

【申込先】 下記のお申込用WEBサイトよりお申込みください。

https://www.jsat.or.jp/Sanjo_TEM220722

【問合せ】 (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 セラミックビル 4F

TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail: staff@jsat.or.jp

2022年 賛助会員会 第1回技術交流会 参加申込書

※WEBサイトからお申込みできない場合は、以下にご記入の上、staff@jsat.or.jpへお申し込みください。

住所			
勤務先. 所属			
参加者氏名			
会員資格	(いずれかに○) 賛助会員 正会員 学生 非会員		
Tel		Fax	
E-mail			
備考			

・1回線で複数の方がご聴講いただく場合、お申し込みは代表者のみで結構です。

・複数の方がそれぞれの回線でご聴講の場合は、おひとり様ずつお申し込みください。